

2025 年 6 月 2 日

各位

会社名	インスペック株式会社
代表者名	代表取締役社長 菅原 雅史 (コード番号：6656 東証スタンダード)
問合せ先	執行役員管理部長 佐藤 保 TEL 0187-54-1888 (代表)

大型受注に関するお知らせ

当社は、主力製品であります半導体パッケージ基板検査装置の大型受注を獲得いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 受注の内容

当社はこの度、かねてより商談を進めてまいりました複数の国内企業より高性能半導体パッケージ基板検査装置等、総額約4.6億円の受注を獲得いたしました。

当該製品につきましては、最先端の AI 半導体製品に使用される超ハイエンド基板等を検査対象としております。これらは、当社が強みを持つ検査装置の性能及びサポート体制がユーザー様から引き続き高く評価された結果であると認識しております。

今後も半導体チップの微細化やチップレット化へ向けた国内外の企業の積極的な投資により更なる市場の拡大が続く半導体パッケージ基板市場向けを中心に顧客のニーズに応え、技術開発と営業活動を一層強化し、受注獲得へ向け全社一丸となって取り組んでまいります。

なお、当社では通期業績予想売上高の10%を目安に大型受注案件として開示しております。



半導体パッケージ基板検査装置イメージ図

2. 業績に与える影響

当該受注案件については、当期中（2026年4月期）に納入予定となりますので、2025年6月13日公表予定の2026年4月期の業績予想に織り込む予定であります。

以上